

Verarbeitungs-Richtlinie VR-00004
 Bleifrei Löten für Tastenmodule MX, ML, M8

Manufacturing Guideline VR-00004
Lead Free Soldering for - MX, ML, M8 Keymodul

MX - Tastenmodule
 MX - Keymodules

ML - Tastenmodule
 ML- Keymodules

M8 – Tastenmodule
 M8 - keymodules



1. Lötorschlag

1.1. Anlage: Seho MWS 2340

1.2. Lot: Sn96Ag3,8Cu

1.3. Sprühfluxer:

-Menge: 20 bis 80 ml/min; v=1,4 bis 2,5m/min.
 Flussmittel: Alpha Rosin Flux 800 (RF 800)
 Hersteller: Fa. Cookson

1.4. Vorheizen:

V=1,5 bis 2,3 m/min.; indirekte, gleichförmige,
 von unten erfolgende Vorheizung über mehrere
 Heizelemente (t=150-400°C);

gemessene Temperatur auf
 LP - Oberseite bis 125°C.

1.5. Löten:

V=1,5 bis 2,2m/min; Lötinkel 0°-7°;
 Tiegeltemperatur: 260 bis 270°C

1. Soldering proposal

1.2. Equipment: Seho MWS 2340

1.2. Solder: Sn96Ag3,8Cu

1.3. Spray flux:

- Quantity: 20 – 80 ml/min.; v=1,4 – 2,5 m/min.
 Flux material: Alpha Rosin Flux 800 (RF 800)
 Manufacturer: Cookson

1.4. Pre - heating:

V=1,5 bis 2,3 m/min.; indirect, steady, from the
 bottom of the PCB effected pre - heating by many
 heating elements (t=150-400°C);

measured temperature on
 PCB-top side max. 125°C.

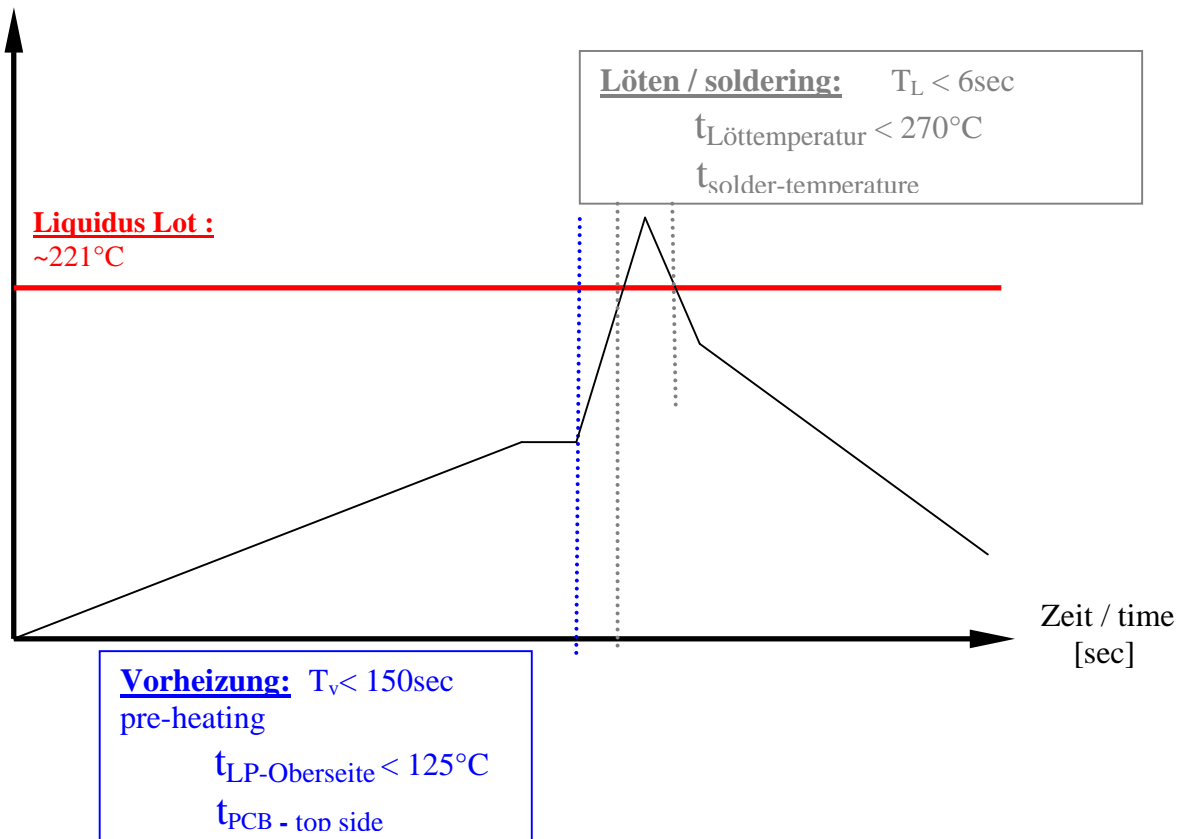
1.5. Soldering:

V=1,5 bis 2,2m/min; Solder angle 0°-7°;
 Solder bath temperature : 260 bis 270°C

01	15.02.06	A. Neuner	156002				
00	27.07.05	A. Neuner	154 264				
Index	Datum	Name	ÄM - Nr.	ECM	LAB	QP-C	AS-TT
Erstellt ECM-NP/AN		H:\ROHS\Lötvorschrift\Lötvorschrift freigegeben\2006_04_20_VR00004_01 Verarbeitungsrichtlinie bleifrei löten.doc				Seite 1 von 3	

1.6. Lötprofil / solder profile:

Temperatur /
temperature
[°C]



01	15.02.06	A. Neuner	156002				
00	27.07.05	A. Neuner	154 264				
Index	Datum	Name	ÄM - Nr.	ECM	LAB	QP-C	AS-TT
Erstellt ECM-NP/AN	H:\ROHS\Lötvorschrift\Lötvorschrift freigegeben\2006_04_20_VR00004_01 Verarbeitungsrichtlinie bleifrei löten.doc					Seite 2 von 3	

2. Warnhinweise:

Eine mechanische Belastung der Modulanschlüsse während des Lötens ist nicht zulässig.

Lötdämpfe sind durch geeignete Maßnahmen vom Tastenmodul fernzuhalten.

Die Tastenmodule sind nicht für Reflow- und SMD - Lötprozesse qualifiziert.

Nach unserer Erfahrung sind Tastenmodule beratungsbedürftige Produkte.

3. Mitgeltende Spezifikationen:

TS-M0001 / TS-M0003 / TS-M0021 / TS-M0027 / TS-M0026

4. Links:

Datenblätter zu Lonco RF 800 Flux, siehe: <http://www.alphametals.com/>

Lötanlagenhersteller, siehe <http://seho.de/>

3. Warning notices:

Mechanical stress on the terminals during the solder process is not allowed!

Solder steam must be discharged from the keymodule.

The keymodules are not qualified for reflow- and SMD solder processes.

Keymodules are products which generally need to be accompanied by advisory service.

3. Further applicable Specifications:

TS-M0001 / TS-M0003 / TS-M0021 / TS-M0027 / TS-M0026

4. Links:

Data sheets about Lonco RF 800 Flux, see: <http://www.alphametals.com/>

Wave soldering systems, see: <http://seho.de/>

01	15.02.06	A. Neuner	156002				
00	27.07.05	A. Neuner	154 264				
Index	Datum	Name	ÄM - Nr.	ECM	LAB	QP-C	AS-TT
Erstellt ECM-NP/AN		H:\ROHS\Lötvorschrift\Lötvorschrift freigegeben\2006_04_20_VR00004_01 Verarbeitungsrichtlinie bleifrei löten.doc				Seite 3 von 3	